

## 特長

- 1 高速伝送対応 (28+Gbps)
- 2 85/100Ω両方に対応したインピーダンス設計
- 3 実装信頼性の高いBGA構造 “Pin in Ball”
- 4 スタッキングハイト : 10~13mm
- 5 嵌合誘い込み構造 ±1.5mm (XY方向)
- 6 複数実装可能  
(実装ずれ許容 XY方向 : ±0.2mm)
- 7 低背構造による実装性の容易化  
(2回リフロー、温度プロファイルのワイドレンジ、検査の容易化)



## 実装誤差吸収フローティング構造

### X軸方向

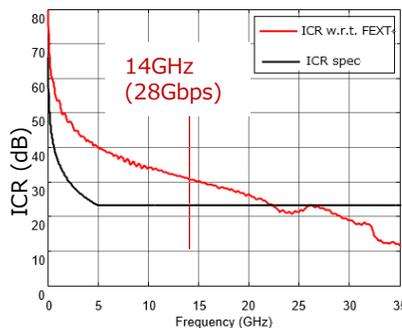


### Y軸方向

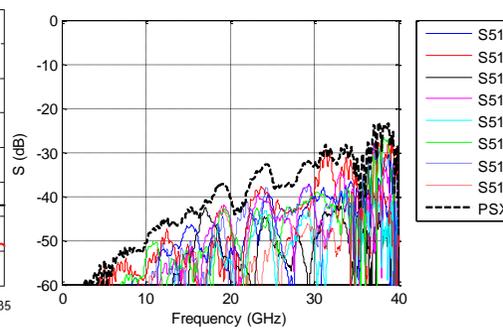


## 28+Gbps SI 性能

### ICR (Insertion-loss to Crosstalk Ratio)



### Crosstalk (FEXT)



## 仕様

定格電流	信号 : 0.5A
定格電圧	50V AC
使用温度範囲	-55 ~ +85 °C
接触抵抗*	50mΩ 以下
耐電圧	150V ACで1分間
絶縁抵抗	1000MΩ 以上 (100V DC)
挿抜回数	100回

\*導体抵抗を含む